

平成 25 年 3 月 18 日

各 位

会社名 シャープ株式会社
代表者名 取締役社長 奥田隆司
(コード番号 6753)

Qualcomm 社に対する第 2 次第三者割当増資について

平成 24 年 12 月 4 日付プレスリリースにて、平成 24 年 12 月 4 日開催の取締役会において、Qualcomm Incorporated（以下「Qualcomm 社」という。）を割当先とし、払込期日を平成 25 年 3 月 29 日とする第三者割当による新株式の発行（以下「第 2 次第三者割当増資」という。）について決定したことをお知らせしておりましたが、当該第 2 次第三者割当増資を実施する条件の充足について協議が継続しており、会社法所定の手続き上、当初予定していた 3 月 29 日の期日に払込みを受けることができない状況となりました。

しかしながら、Qualcomm 社とは、今後も継続して協議していく予定ですので、かかる協議が整い次第、お知らせいたします。

以 上